

证券代码：688372
转债代码：118055

证券简称：伟测科技
转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	信达证券、汇丰前海证券、财通资管、安联基金、圆信永丰基金、金鹰基金、溪牛投资、摩根大通、泰康基金、全天候私募、平安证券、国泰基金、招商证券、弈宸私募、通怡投资、国信证券、上海证券、中泰证券、墨钜资产、淳厚基金、大朴资产、融通基金、鑫元基金、东北证券、西南证券、泰康资产、兴银基金、诺安基金、华夏基金、中信资管、浙商证券、中信建投、永赢基金、北大方正人寿、华能贵诚信托、光证资管、长江证券、天风证券、森锦投资、人保资产、东吴证券、中信保诚资产、远望角投资、利位私募、东方财富证券、涌津投资、胤胜资产、弥远投资、新泉投资、翀云私募、国联民生证券、Point72、成泉资本、华金证券、财通证券、华安证券、明河投资、重阳投资、景顺长城基金、高毅资产、兴证全球基金、嘉实基金、华源证券、广发证券、雷钧私募、华福证券、惠升基金、粤开证券、摩根基金、华泰证券、国投瑞银、银叶投资、宏利基金
时间	2025年12月4日、2025年12月5日
地点	无锡伟测半导体科技有限公司（三期）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：骈文胜先生 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王沛女士

投资者关系活动主要内容介绍

投资者提问

1、怎么看待当前半导体封测格局？

答：目前，中国台湾在全球半导体后端工序（制造+封测）中仍处于主导地位，中国大陆正在高速追赶。受益于AI、智能驾驶、大数据中心等领域的快速增长，拉动了本土封测需求，以及受制于外部BIS清单管制和“China for China”策略的驱动，无论是本土芯片设计公司还是希望在中国市场销售的海外IDM都更倾向于在中国大陆封测，追求成本、安全和本土化的订单（尤其是FT）加速向大陆回流，为大陆测试业务带来新增量。

2、怎么看待半导体分工演变趋势？

答：历史规律告诉我们合久必分，分久必合。在台积电创立之前，半导体产业主要是IDM模式。自台积电创立了Foundry模式，开启了产业专业分工的时代。分工使得设计公司（Fabless）可以专注于创新，代工厂（Foundry）和封测厂（OSAT）通过规模效应和专业化提升效率、降低成本。由于外部政策的原因，又使得国内一些大型公司出于国家战略和安全考虑不得不逆流再整合。但封测环节的专业化分工从产业规律看仍是长期趋势，并且会出现标杆企业来定义标准、做大市场、引领生态。希望伟测可以成为中国大陆第三方测试的引领者。

3、公司测试的存储芯片是哪个类型？

答：目前公司测试的存储芯片种类为Nor Flash。主要由于其他种类存储芯片测试主要以IDM模式为主且客户高度集依赖度过高以及专用测试设备投资巨大；而Nor flash 客户分散且测试设备普适性更强。

4、测试存储芯片和SoC芯片有什么不同？

答：从测试方案、测试程序和测试设备基本都不一样。

5、展望下未来高端产品的结构占比？

答：高端计算芯片（CPU/GPU/AI）在中国本土市场的占比仍然非常低，但受益于全球AI算力需求爆发及国产替代进程加快，未来成长空间巨大，高可靠性芯片（汽车电子）受益于中国新能源汽车崛起而快速增长，但在全球市场占比仍很低。随着市场更多转向高端计算和汽车电子，CPU/GPU/AI芯片和汽车电子芯片，在中国设计公司的产品组合中占比必将逐渐上升，处于产业链上的测试环节必将同步升级。

6、测试价格是否有变化？

答：测试价格在2022-2023年期间由于市场需求疲软、行业处于下行周期导致价格有所下沉，一旦降价的产品很难直接回调。随着旧产品生命周期结束，原有的低价测试需求自然衰减，以及新的产品和新客户的加入使得整体均价逐步回归正常水平。

7、公司的竞争优势？

答：首先公司战略定位清晰，聚焦高算力芯片、先进架构及先进封装芯片、高可靠性芯片的测试需求，逆周期扩张高端产能，产能已具备行业领先潜力；其次公司客户结构优质，已切入众多国内顶级客户的供应链；然后公司依托上市平台，拥有更便捷的融资渠道和更强的资金实力，能够支撑大规模、高频率的资本开支；最后公司拥有快速响应客户需求的能力。

8、测试设备国产替代进度？

答：在中低端可以实现较大比例替代，在中高端领域仍有显著差距。

9、设备交期多久？

答：像比较高端的设备基本上交期为6个月。

10、算力业务营收增长除了芯片数量驱动还来自于哪些方面？未来成长空间来自于更多产品线还是更多主流客户？

答：算力芯片除了量的增长还有测试的复杂程度更高一些、测试时间更长。国内算力类主流客户公司已基本覆盖，另一方面我们相信主流客户的产出以后也会更大。

11、现金流回款速度？

答：平均2-3个月。

12、高端设备产能是否紧张？

答：在全球AI算力需求爆发性的驱动下，高端测试设备出现阶段性紧张是正常的，但这并非供应能力的绝对短缺导致的。设备商具备扩产能力且寻求客户多元化，而谁能获得设备，取决于谁更有预见性，更早进行战略布局和下单锁定产能。我司凭借精准的市场预判和早期布局，确保了设备的按期交付。

13、有没有可能在海外扩产？

答：目前没计划。首先国内半导体设计公司崛起，本土测试市场潜力巨大；其次全球半导体制造与封测中心向正中国大陆转移；最后地缘政治和外部政策等原因会使得海外拓展产生更多不确定性。

14、展望下CP和FT收入的比例？

答：主要还是以CP为主。CP主要由第三方专业测试公司主导，格局相对稳定。FT主要由第三方测试公司与封测一体化工厂共同竞争，周期性波动较强。市场好、产能紧张时，封装厂更倾向于将FT订单交给第三方测试公司；市场不好、产能宽松时，封测厂为了填满自己的产能，更倾向于自己消化。

15、同样的设备，客户为什么选择伟测？

	<p>答：公司管理层专注厂内打磨极致品质（高良率、零事故）、精细化的内部管理、提供高性价比和低风险赢得客户长期信任与合作。</p> <p>16、设备的折旧年限为10年，实际情况大概多久？</p> <p>答：泰瑞达、爱德万等高尖端测试平台寿命可达20-25年以上，通过升级持续满足新的测试需求。很少设备是因为坏了不能用，主要是因为测试效率低下、经济成本过高和技术能力不足而淘汰。设备的实际使用年限可能远长于折旧年限，也可能因技术迭代加速而短于折旧年限。</p>
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单（如有）	无